

IECQ認定事業所一覧表

製造業者認定 [ISO 9001:2008 = 17 事業所]

(2011-11-14 現在)

認定事業所 / 所在地	認定日/更新日	認定番号	国際規格	適用除外項目	品 種 名
株式会社トッパンNEC サーキットソリューションズ 東京都港区芝浦3-19-26	1987-04-28 2011-03-14	RCJ-87M-02H	ISO 9001:2008	なし	プリント配線板
アスワ電子工業株式会社 福井県福井市江守中2丁目1321番	1992-11-25 2010-11-08	RCJ-92M-08D	ISO 9001:2008	7.3項 7.4.1項の一部	LCフィルタ、ノイズフィルタ、ラインフィルタ
三和電子サーキット株式会社 美原工場 大阪府堺市美原区木材通1-4-5	1994-05-31 2010-05-18	RCJ-94M-14H	ISO 9001:2008	なし	多層プリント配線基板
SEMITEC株式会社 千葉県千葉市花見川区天戸町1319-1	1994-05-31 2011-03-14	RCJ-94M-16C	ISO 9001:2008	なし	サーミスタ
エルナー株式会社 プリント回路事業本部 滋賀県長浜市田町30番地	1994-07-04 2010-06-30	RCJ-94M-17D	ISO 9001:2008	なし	プリント配線板
栄通信工業株式会社 見附工場 (阿賀野工場を含む) 新潟県見附市本所2丁目2番8号 新潟県阿賀野市寺社甲140-1	1994-08-08 2010-08-02	RCJ-94M-28D	ISO 9001:2008	なし	ポテンショメータ、ジョイスティックコントローラ
株式会社JVCケンウッド カーエレクトロニクス事業 グループ オプティカルコンポーネント統括部 株式会社J&Kオプティカルコンポーネント 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12	1994-10-11 2011-11-14	RCJ-94M-310	ISO 9001:2008	なし	光部品(光ピックアップ)
株式会社エイト工業 神奈川県横浜市港北区綱島東6-7-9	1994-11-18 2009-11-16	RCJ-94M-34D	ISO 9001:2008	7.3項	プリント配線板
株式会社 ミズサワセミコンダクタ 岩手県奥州市水沢区水沢工業団地二丁目37番地	1994-12-26 2009-11-16	RCJ-94M-36C	ISO 9001:2008	7.3項	個別半導体デバイス、半導体集積回路

※ 品種名欄の[]内の記号は品質認証の認証番号を示す。

認定事業所 / 所在地	認定日/更新日	認定番号	国際規格	適用除外項目	品 種 名
山一電機株式会社 (佐倉事業所、岡山分室を含む) 東京都大田区中馬込3-28-7 本社 東京都大田区中馬込3-28-7 佐倉事業所 千葉県佐倉市大作1-4-1 (諏訪分室 長野県茅野市金沢5695-6を含む) 岡山分室 岡山県浅口市鴨方町小坂西3000-1	1995-02-01 2010-12-10	RCJ-95M-01K	ISO 9001:2008	なし	コネクタ、ICソケット、電子基板、プローブピン
山下マテリアル株式会社 サーキテックカンパニー 神奈川県座間市小松原1-44-12	1995-05-11 2010-05-10	RCJ-95M-09C	ISO 9001:2008	なし	プリント配線板及びプリント回路板(実装品)
穴水電子工業株式会社 石川県鳳珠郡穴水町大町子の53番地	1995-07-28 2010-07-12	RCJ-95M-14D	ISO 9001:2008	7.3項 7.4.1項の一部	チップコイル
リバーエレテック株式会社 山梨県韮崎市富士見ヶ丘2-1-11	1995-07-28 2011-06-13	RCJ-95M-15I	ISO 9001:2008	なし	水晶振動子、水晶発振器
岩手ニッカン株式会社 岩手県紫波郡紫波町赤沢木戸脇121-133	1995-11-27 2010-11-08	RCJ-95M-24C	ISO 9001:2008	なし	プリント配線板用銅張積層板、電気絶縁用積層板、 多層プリント配線板用プリプレグ
株式会社村田製作所 野洲事業所 半導体製造部 滋賀県野洲市大篠原2288番地	1997-10-21 2010-10-12	RCJ-97M-07G	ISO 9001:2008	7.3項	化合物半導体及びその集積回路
東芝ホクト電子株式会社 北海道旭川市南5条通23丁目1975番地	2001-10-26 2010-10-12	RCJ-01M-01E	ISO 9001:2008	なし	サーマルプリントヘッド(TPH)、フレキシブルプ リント板(FPC)
株式会社国見メディアデバイス 福島県伊達郡国見町大字山崎字北町田三番地	2011-02-14 2011-02-14	RCJ-11M-01	ISO 9001:2008	なし	個別半導体部品、混成集積回路(ベアチップ/実装・ 混在搭載)の設計・開発及び製造、混成集積回路(ベア チップ/実装・混在搭載)の製造工程の一部

※ 品種名欄の[]内の記号は品質認証の認証番号を示す。